

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年5月23日-24日)

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	东方证券、民生证券、中信建投、银华基金、景顺长城、远希私募、珩道投资
时间	2024年5月23日-24日
地点	线上会议 灿勤科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：陈晨女士 证券事务代表：钱志红女士
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 第二部分：问答环节 1、问：公司的主营业务是什么，有哪些应用领域？ 答：公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司自成立以来，依托在陶瓷粉体配方和产品制备工艺领域的持续研发和经验积累，始终专注于电子陶瓷元器件的研制和开发。公司通过向客户提供高效稳定、专业可靠的元器件产品及通信解决方案，不断提升企业的品牌与价值。谢谢。 2、问：公司的产品能用在5.5G基站上吗？

答：公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用 sub-6GHz 频段内的各应用场景，包括 4G、5G、5.5G 等 FDD 架构通信网络。公司将持续跟踪 5.5G、6G 技术发展动态，做好相关的预研及技术储备，与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展，积极参与客户的解决方案。谢谢。

3、问：公司的产品有用到卫星上吗？

答：公司的产品有应用于星网计划，公司将与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展。谢谢。

4、问：目前公司募投项目“新建灿勤科技园项目”进展情况如何？

答：公司募投项目“新建灿勤科技园项目”分三期建设。一期工程“新建 HTCC、LTCC 产品线项目”目前已全面完成封顶，幕墙和外立面装修工程也已经全部完工，部分厂房已完成转固，达到预定可使用状态；二期工程“新建电子陶瓷研究院项目”已于 2023 年开工，预计 2025 年上半年竣工；三期工程“新建介质波导滤波器产能扩张项目”计划于今年下半年动工，预计 2025 年竣工。谢谢。

5、问：公司 2023 年及 2024 年第一季度的经营业绩情况？

答：2023 年，公司财务状况良好，总资产 23.50 亿元，较年初增加 1.41%，归属于上市公司股东的净资产 21.36 亿元，较年初增加 1.42%，主要系本年归属于上市公司股东的净利润所致。2023 年，公司实现营业收入 36,989.36 万元，较上年同期增长 7.16%，主要系公司以技术创新推动产业发展，持续加大研发投入，持续开发新的产品型号，不断开拓新的市场，营业收入持续增长；归属于母公司所有者的净利润 4,673.56 万元，较上年同期下降 40.55%，主要原因是公司收到的政府补助与上年同期相比减少 3,376.36 万元，理财收益与上年同期相比减少 549.27 万元，导致净利润变动较大。扣除上述非经常性损益的影响，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少 55.44 万元，主要系公司的销售费用、研发费用及管理费用有所增加。

2024 年第一季度营业收入 8,160.97 万元，较上年同期减少 5.80%，归属于上市公司股东的净利润 1,457.35 万元，较上年同期增长 43.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 941.96 万元，较上年同期增长 117.88%，公司本期净利润上升主要原因包括：1、对比的去年同期净利润基数较低；2、公司持续开发新产品、拓展新市场，本期产品结构的变化带来主营业务毛利率有所提升；3、存款利息的增加导致财务费用减少；4、股份支付费用的减少导致管理费用减少。谢谢。

6、问：公司 HTCC 产品的进展情况？

	<p>答：公司目前已建成完整的 HTCC 自动化设备产线，建立了 HTCC 产品线端到端的能力。从产品设计、陶瓷材料制备、瓷体成型、烧结、表面金属化、钎焊组装、测试检验、试验分析等可全部由公司内部完成。在 HTCC 陶瓷材料领域，根据不同应用场景，公司已开发出 92/95/96/99 氧化铝等成熟配方 8 种，并着手于高导热氮化铝、氮化硅陶瓷材料研发。在 HTCC 制造工艺领域，公司已实现单层厚度最小 0.1mm，最小孔径 0.1mm，最小线宽 50um，最小线距 50um 的极限工艺能力，适用于高精度 HTCC 产品制造。在 HTCC 封装产品形态方面，公司已完成微波 SIP、微波功率管壳、CMOS、光通信、光耦合器封装、CPGA、CBGA、CQFN、CLCC、CSOP、CQFP 等系列封装产品的开发和送样；其中微波 SIP 等产品已取得客户认可，开始小批量交付使用。在陶瓷基板产品形态领域，公司数款 DPC 陶瓷基板已完成小批量交付验证。</p> <p>公司控股子公司频普半导体目前已具备薄膜电路及相关薄膜 MEMS 无源器件的批量生产能力，部分毫米波薄膜无源器件已经开始批量生产，目前开发的新一代环形器复合陶瓷基板及半导体薄膜基板，已经取得一定的客户订单。</p> <p>控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富，应用于半导体散热基板、3C 终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作，并取得阶段性进展。谢谢。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 24 日